

マイクロフォーカスX線CTシステムの新規導入のご案内

「地域オープンイノベーション促進事業」により、マイクロフォーカスX線CTシステムを導入しました。今後、京都府内企業の皆様に、非破壊試験等でご活用いただき、新製品開発や品質管理にお役立ていただきますようご案内いたします。

1. 主な特徴・仕様

様々な工業製品の内部構造を非破壊で検査し、断層画像や3次元画像を得ることができます。内部構造を可視化することで、欠陥箇所の抽出や形状の観察が容易となり、構造解析や製造方法の検証などを、スピーディーに行うことが可能となります。

■メーカー・型式

東芝ITコントロールシステム株式会社 TOSCANER-32300 μ FD

■仕様

X線発生器：電圧230kV／焦点サイズ：4 μ m

検出器：8インチフラットパネルディテクタ

搭載可能サイズ： ϕ 320×H300mm／15kg

最大スキャンエリア： ϕ 260×300mm

■特徴

X線を透過させて部品内部の状態を非破壊で観察

高画質が得られるフラットパネルディテクタ

空間分解能：5 μ m

■用途

電子デバイス、実装基板、小型アルミダイカスト、二次電池等



2. 活用事例

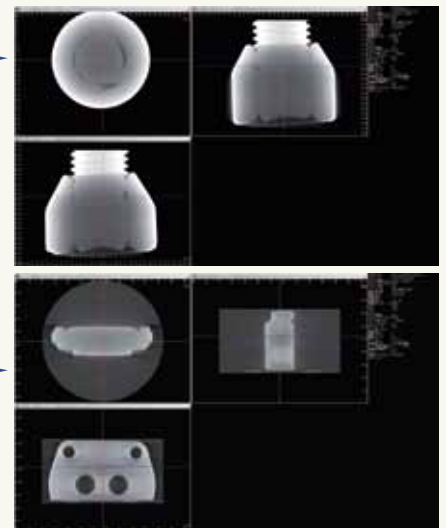


ボルトとナットの噛み合わせが悪い。
断面はどのようになっているのか？

電子部品や工業製品の内部の形状を
非破壊で観察したい。



ダイカスト製品内部の
空隙を非破壊で
検査したい。



3. 使用料(基本額)

- 機器貸付 1時間あたり 4,000円
- 依頼試験 1測定あたり 8,000円

※機器のご利用に関しましては、操作説明をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気・電子担当 TEL:075-315-8634 FAX:075-315-9497 E-mail:ouyou@mtc.pref.kyoto.lg.jp